



【東京/武蔵村山】機械設計（半導体製造装置） ◆ヤマハ発動機グループ

ヤマハロボティクス株式会社での募集です。 機械設計・機構設計・筐体設計・メカト...

Job Information

Recruiter

JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company

ヤマハロボティクス株式会社

Job ID

1592504

Industry

Electronics, Semiconductor

Job Type

Permanent Full-time

Location

Tokyo - Other Areas

Salary

4.5 million yen ~ 7.5 million yen

Work Hours

08:45 ~ 17:30

Holidays

【有給休暇】有給休暇は入社時から付与されます 初年度 採用月に応じて2日~15日 1か月目から 【休日】完全週休二日制 土日...

Refreshed

May 14th, 2026 16:03

General Requirements

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

None

Minimum Japanese Level

Native

Minimum Education Level

Technical/Vocational College

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB2335265】

MISSION

半導体製造装置（ボンディング装置）メーカーである同社において、機械設計職の募集です。

[取扱い製品]

ワイヤボンダ、ダイボンダ、 bumpsボンダ、フリップチップボンダ、等

半導体製造装置の新機種開発、カスタマイズ設計をご担当いただきます。
顧客要望のヒアリングから仕様検討、設計、出図業務、試運転立ち合いまで一貫してかかわることができるのが魅力です。

※残業想定時間：20時間程度を想定

■半導体ボンディング装置のパイオニア企業

1970年代後半、それまで人の手で行われていたワイヤボンディング（半導体製造における後工程作業）の全自動化に成功したのは当社です。競争が増えた今、当社の強みは品質No.1であり仕様に沿ってカスタマイズ設計ができること。この丁寧さは今後も捨てずに、日本企業としての自信・自負をもって世界No.1であり続けるのが私たちの目標です。

□主力製品「フリップチップボンダ」について

半導体製造のための精密ロボットです。
ウェハー上に形成された半導体素子を、反転（フリップ）させて基板上
もしくはウェハー上へボンディングする為の装置で、従来のワイヤボンディングに
替わる新しい実装技術になります。
最新のスマートフォンやデータセンタの中心的な役割を果たすICを
製造する為の装置です。
メカトロニクス技術はもちろん、制振制御、ロボティクス、材料工学、
画像処理技術などあらゆる最先端の技術がつまっています。

Required Skills

【必須条件】
・機械装置、産業機器の設計や駆動系開発のご経験

Company Description

ヤマハロボティクス株式会社（Yamaha Robotics Co. Ltd.）は、ヤマハ発動機株式会社グループにおいて半導体製造装置（後工程）および電子部品組み立て装置事業を担う会社です。